

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2021-134

安徽晶赛科技股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日接待了25家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2021年12月24日

调研形式：网络调研

调研机构：申万宏源证券研究所股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中山证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、ConesisCapital、中天证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、永安财险股份有限公司、尚正基金管理股份有限公司、东方证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、翰潭投资股份有限公司、华兴证券股份有限公司、英大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华平证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

上市公司接待人员：公司董事长侯诗益先生、董事会秘书侯雪女士。

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1: 公司对未来5年行业需求是什么判断的？更多的是在什么场景打开市场？

我们认为未来几年石英晶振行业还会存在一定的需求增量，增量的来源主要

有以下 2 个方面：（1）石英晶振作为数字电路及无线通讯应用端不可缺少的基础零部件，随着通讯技术不断发展，智慧电子产品的不断普及，新增的应用场景会越来越多，因此将会带来新增的市场需求；（2）随着下游客户对国产晶振产品认可度的提升，进口替代将会给中国大陆企业带来一定的市场增量。综上，我们认为长期来看石英晶振产品的需求量有一定的成长空间，当然某一时段内的下游需求量也会受宏观经济、贸易环境等多方面因素的综合影响。

石英晶振的下游应用领域极为广泛，未来物联网、智能家电、新能源汽车等领域预计会有较大的增长空间，公司市场拓展不会局限于某一特定领域。

问题 2: 公司温补晶振、热敏晶振等产品的研发进展？

公司热敏晶振产品研发已完成，正处于送样认证阶段，尚未形成规模销售；温补晶振等正在研发中。

问题 3: 公司募投产能较大，未来的投放节奏如何？

募投项目中的产业化项目预计将于 2 年内完成投资建设工作，投产过程中产能将逐步均匀释放，预计 3 年内实现产能达产。

问题 4: 募投产能消化方式是通过拓展新客户、新应用场景为主吗？还是在深耕大客户？

公司募投产能消化将以拓展新客户为主，目前公司市场开发工作正在有序开展中，同时下游应用场景增加也会促进公司现有客户需求量的增长，公司会努力服务好现有客户，把握好现有客户的新需求增长。

问题 5: 公司盈利能力近几年一直维持稳定状态，公司在成本控制上是采取了什么策略？

公司通过控制产品制程良率、管控原材料采购价格、提高设备使用效率等方式控制产品成本。

问题 6: 销售人员占比较低，人员招聘进展如何？

公司现有销售团队人员稳定且具有较为丰富的市场开发经验，能够胜任相关的市场开发工作。为适应公司持续发展的需求，公司会根据业务拓展的需要及时开展人员招聘工作。

问题 7：未来的招聘会侧重销售端还是研发、生产端？

公司会根据企业发展的实际情况进行人员招聘，目前我们对研发、生产管理类的人才需求量更大。公司始终重视各类人才的储备与培训工作，注重员工的综合能力培养，公司的销售人员一般都具备一定的产品技术基础，以便给客户带来较好的服务体验。

问题 8：公司能介绍一下晶片光刻技术的布局和未来规划吗？

光刻工艺主要用于生产 1210 及以下尺寸晶振的晶片加工环节，1612 及以上尺寸产品的晶片主要采用传统的切割研磨方式加工，国内的晶片供应商较多、采购难度较小，未来大尺寸产品使用的晶片公司仍将以采购为主，小尺寸和超高基频晶片公司未来计划量产。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日